



## 芯系未来系列活动（第二十六期）顺利开展

发布日期: 2022-10-04 点击: 58

启航“芯”征程、争做“芯”青年。为帮助提高学生的芯片安全意识，普及芯片设计安全要求，10月2日晚，微电子学院举办了“芯系未来”系列活动（第二十六期）——从安全测评的角度看芯片设计安全要求。本次活动由高维密码测评技术（山东）有限公司实验室主任张浩主讲，学院党委副书记崔剑主持活动。



首先，张浩向大家展示了产品测评的必要性和原因。他指出，“产品测评是对产品所有的功能、所有的特征、所有的指标进行的测评。”通过列举汽车、口罩等例子，他指出产品测评既可以为消费者提供评估渠道，又可以为产品本身提供证明和数据支撑。随后，张浩进一步概述了产品测评流程。

接着，张浩为我们深入讲解了安全测评的必要性。从国家号召到法律要求再到社会影响，张浩宏观地阐释了安全测评的必要性，借助三个有关摄像头安全的小实验，用最直观的方式将现实生活中物联网设备的安全风险生动地展现在大家眼前。讲到当前测评体系中的芯片安全测评，他强调，“芯片安全测评是物联网或者信息系统一切安全的底柱”，并介绍了一些芯片测评机构以及它们对应的测评体系、测评流程、测评等级、测评标准以及测评对象等内容。

最后，张浩借助芯片安全测评要求介绍了当下芯片设计的共同标准。芯片的安全等级分为三级，如我国银行卡则为国民二级安全芯片。国民二级安全芯片在密码局的检测项目共九项：密码算法、安全芯片接口、密钥管理、敏感信息保护、固件安全、自检、审计、生命周期保证和攻击的削弱与防护。一个好的芯片缺其一角难成其圆，因此，张浩又逐一介绍了不同的安全等级对应的每个检测项目的不同检测标准。



新时代、“芯”征程，国家芯片产业发展路漫漫其修远兮，同学们当上下求索、行而不辍，方能迎来中国芯产业的可期未来，向世界的大舞台展现中国“芯”力量。

本次活动是芯系未来系列——“芯业态”的第9场活动，为同学们普及了芯片安全测评的必要性和芯片设计安全要求的标准，拓宽了同学们在芯片设计方面的眼界，为同学们在未来的科研与学习中提供更多的专业知识和参考。

文/胡泊 余勇生

【关闭】

上一条: 芯系未来系列活动（第二十七期）顺利开展

下一条: 芯系未来系列活动（第二十五期）顺利开展

